

# 2018-2024年中国半导体封装用键合丝产业市场发展需求调研与未来发展方向研究报告

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2024年中国半导体封装用键合丝产业市场发展需求调研与未来发展方向研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/312117312117.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

### 1、键合丝行业管理体制、主要法律法规

#### (1) 行业管理体制

键合丝是半导体封装专用材料，属于半导体行业中的半导体封装材料子行业，也可归属于电子材料行业的半导体材料子行业。

半导体封装材料行业主管部门是国家工业和信息化部，主要负责制订我国半导体封装材料行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。

中国半导体行业协会则是由全国半导体行业从事集成电路、半导体分立器件、半导体封装材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位及其它相关的企、事业单位自愿参加的、非营利性的、行业自律的全国性社会团体，下设半导体封装分会等五个分会，在政府和会员单位之间发挥桥梁和纽带作用，促进半导体行业的发展。中国电子材料行业协会是由从事电子材料的生产、研制、开发、经营、应用、教学的单位及其他相关的企、事业单位自愿结合组成的全国性的行业社会团体，下设半导体材料分会等十个分会，是政府对电子材料行业实施行业管理的参谋和助手，在政府部门和企业（事业）单位之间起桥梁纽带作用。

#### (2) 主要法律法规

半导体行业的市场化程度很高。国家发改委、商务部等政府部门通过颁布《产业结构调整指导目录》、《外商投资产业指导目录（2015年修订）》等政策性文件，对国民经济各行业的投资活动和企业的生产经营活动进行管理和调节，键合丝行业同样接受上述政策性规定的管理。

键合丝生产过程属于有色金属物理加工，生产过程中不涉及有毒有害原料和有毒有害“三废”，国家对键合丝行业的研发、生产、销售不存在特殊管制。

### 2、键合丝行业概况

键合丝属于半导体封装五大重要结构材料之一，是半导体封装专用材料，属于半导体行业中的半导体封装材料子行业，也可归属于电子材料行业的半导体材料子行业。

### （1）全球键合丝行业竞争格局和市场化程度

随着近年来电子技术的日新月异，智能家电、数码、汽车电子的不断更新换代，促使半导体封装业整体规模不断扩展。从地域竞争来看，目前中国、德国、日本、韩国等是全球键合丝主要生产国，其技术研发能力以及产品的种类、产量、质量均居世界前列。根据统计，2016年大中华区键合丝行业已占据全球市场份额的45%左右。亚洲其它新兴国家（不含中国内地、日本）市场份额上升也很快。

### （2）国内键合丝行业竞争格局和市场化程度

随着半导体封装业的快速发展，加之近几年国内以LED为代表的电子材料行业飞速崛起，催生了我国键合丝市场的旺盛需求，推动了键合丝产业的不断发展壮大。据半导体行业协会初步统计，2016年全球键合丝需求总量在260亿米以上。

目前，国内部分键合丝生产企业已经达到国际同等水平，但由于起步晚，键合丝生产企业数量多、规模小。国内较早一批具有一定影响力的键合丝生产企业主要为国际知名键合丝制造商在国内的独资或合资企业，近几年部分内资企业发展很快，已具有与国际键合丝巨头竞争的能力。

### （3）行业内的主要企业及其发展状况

#### 全球主要键合丝生产企业

目前中国、德国、日本、韩国等是全球键合丝主要生产国，主要生产企业包括日本田中贵金属株式会社、德国贺利氏控股集团、韩国MK电子有限公司、韩国Heesung及台湾乐金股份有限公司、台湾钰成金属公司等。

其中，日本田中贵金属株式会社、德国贺利氏控股集团属于国际上较早从事键合丝生产的大型企业，目前在全球键合丝行业中仍具有较强影响力。

#### 国内贵金属电镀化工材料行业的主要企业

国内目前主要键合丝生产企业主要有贺利氏（招远）贵金属材料有限公司、贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司、田中电子(杭州)有限公司、上海住友金属矿山电子材料有限公司、宁波康强电子股份有限公司、北京达博有色金属焊料有限责任公司、山东科大鼎新电

子科技有限公司、铭凯益电子（昆山）有限公司等。

根据统计，2016年贺利氏（招远）贵金属材料有限公司全年键合丝总销售量达20亿米以上，大幅领先于其他键合丝生产商，是国内键合丝行业领军企业。除贺利氏（招远）贵金属材料有限公司外，北京达博有色金属焊料有限责任公司、宁波康强电子股份有限公司、铭凯益电子（昆山）有限公司等均为国内主要键合丝供应商。

### 烟台招金励福贵金属股份有限公司在键合丝市场份额

目前国内主要键合丝生产企业尚无权威公开数据，根据烟台招金励福贵金属股份有限公司产量，公司在行业的市场份额约为：

表：市场份额

观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）发布的《2018-2024年中国半导体封装用键合丝产业市场发展需求调研与未来发展方向研究报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

## 第一章中国半导体封装用键合丝行业发展概述

### 第一节半导体封装用键合丝行业概述

#### 一、半导体封装用键合丝的定义

#### 二、半导体封装用键合丝的特点

### 第二节半导体封装用键合丝上下游产业链分析

#### 一、产业链模型介绍

#### 二、半导体封装用键合丝行业产业链分析

### 第三节半导体封装用键合丝行业生命周期分析

#### 一、行业生命周期概述

## 二、半导体封装用键合丝行业所属的生命周期

### 第四节行业经济指标分析

- 一、赢利性
- 二、附加值的提升空间
- 三、进入壁垒 / 退出机制
- 四、行业周期

## 第二章2017年世界半导体封装用键合丝市场运行形势分析

### 第一节2017年全球半导体封装用键合丝行业发展回顾

#### 第二节亚洲地区主要市场概况

#### 第三节欧盟主要国家市场概况

#### 第四节北美地区主要市场概况

### 第五节2016-2017年世界半导体封装用键合丝发展走势预测

## 第三章2017年中国半导体封装用键合丝产业发展环境分析

### 第一节2017年中国宏观经济环境分析

- 一、GDP历史变动轨迹分析
- 二、固定资产投资历史变动轨迹分析
- 三、2017年中国宏观经济发展预测分析

### 第二节半导体封装用键合丝行业主管部门、行业监管体

### 第三节中国半导体封装用键合丝行业政策环境分析

### 第四节2017年中国半导体封装用键合丝产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

## 第四章2017年中国半导体封装用键合丝产业运行情况

### 第一节中国半导体封装用键合丝行业发展状况

- 一、半导体封装用键合丝行业市场供给情况
- 二、半导体封装用键合丝行业市场需求情况
- 三、半导体封装用键合丝行业市场容量

### 第二节中国半导体封装用键合丝行业价格走势分析

- 一、半导体封装用键合丝行业价格影响因素分析

二、2017年半导体封装用键合丝行业价格走势回顾

三、2016-2017年半导体封装用键合丝行业价格走势预测

第三节中国半导体封装用键合丝行业技术发展分析

第四节半导体封装用键合丝行业未来发展趋势预测

第五章中国半导体封装用键合丝市场发展分析

第一节中国半导体封装用键合丝行业竞争现状

第二节中国半导体封装用键合丝行业集中度分析

一、市场集中度

二、企业集中度

三、区域集中度

第三节半导体封装用键合丝行业品牌现状分析

第四节中国半导体封装用键合丝行业存在的问题

第五节中国半导体封装用键合丝行业国际竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第六章2017年中国半导体封装用键合丝行业竞争情况

第二节行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第三节半导体封装用键合丝行业SWOT分析

一、优势

二、劣势

三、机会

四、威胁

第四节中国半导体封装用键合丝产品竞争力优势分析

一、整体产品竞争力评价

二、产品竞争力评价结果分析

### 三、竞争优势评价及构建建议

#### 第七章2016-2017中国半导体封装用键合丝所属行业主要数据监测分析

##### 第一节2015-2017中国半导体封装用键合丝所属行业总体数据分析

一、2015年中国半导体封装用键合丝所属行业全部企业数据分析

二、2016年中国半导体封装用键合丝所属行业全部企业数据分析

三、2017年中国半导体封装用键合丝所属行业全部企业数据分析

##### 第二节2015-2017中国半导体封装用键合丝所属行业不同规模企业数据分析

一、2015年中国半导体封装用键合丝所属行业不同规模企业数据分析

二、2016年中国半导体封装用键合丝所属行业不同规模企业数据分析

三、2017年中国半导体封装用键合丝所属行业不同规模企业数据分析

##### 第三节2015-2017中国半导体封装用键合丝所属行业不同所有制企业数据分析

一、2015年中国半导体封装用键合丝所属行业不同所有制企业数据分析

一、2016年中国半导体封装用键合丝所属行业不同所有制企业数据分析

一、2017年中国半导体封装用键合丝所属行业不同所有制企业数据分析

#### 第八章半导体封装用键合丝行业重点生产企业分析

##### 第一节企业一

一、企业概况

二、主营业务情况分析

三、公司运营情况分析

四、公司优劣势分析

##### 第二节企业二

一、企业概况

二、主营业务情况分析

三、公司运营情况分析

四、公司优劣势分析

##### 第三节企业三

一、企业概况

二、主营业务情况分析

三、公司运营情况分析

四、公司优劣势分析

##### 第四节企业四

一、企业概况

二、主营业务情况分析

### 三、公司运营情况分析

### 四、公司优劣势分析

#### 第五节企业五

##### 一、企业概况

##### 二、主营业务情况分析

##### 三、公司运营情况分析

##### 四、公司优劣势分析

## 第九章2018-2024年半导体封装用键合丝行业发展预测

### 第一节2018-2024年中国半导体封装用键合丝行业未来发展前景分析

#### 一、2016-2017年中国半导体封装用键合丝市场发展环境分析

#### 二、2018-2024年中国半导体封装用键合丝行业市场规模预测

#### 三、2018-2024年中国半导体封装用键合丝行业市场发展趋势分析

### 第二节2018-2024年中国半导体封装用键合丝行业市场供需预测

#### 一、2018-2024年中国半导体封装用键合丝行业供给预测

#### 二、2018-2024年中国半导体封装用键合丝市场需求预测

### 第三节2018-2024年中国半导体封装用键合丝行业盈利走势预测

## 第十章2018-2024年中国半导体封装用键合丝行业投资风险与营销分析

### 第一节2016-2017年半导体封装用键合丝行业进入壁垒分析

### 第二节2016-2017年中国半导体封装用键合丝行业投资环境分析

### 第三节中国半导体封装用键合丝行业投资风险

#### 一、政策风险

#### 二、技术风险

#### 三、竞争风险

#### 四、原材料风险

#### 五、其他风险

### 第四节中国半导体封装用键合丝行业营销分析

#### 一、渠道构成

#### 二、销售贡献比率

#### 三、覆盖率

#### 四、销售渠道效果

#### 五、价值流程结构

## 第十一章2018-2024年中国半导体封装用键合丝行业发展策略及投资建议

## 第一节半导体封装用键合丝行业市场的关键客户战略实施

- 一、实施关键客户战略的必要性
- 二、合理确立关键客户
- 三、对关键客户的营销策略
- 四、强化关键客户的管理
- 五、实施关键客户战略要重点解决的问题

## 第三节观研天下投资建议

- 一、重点投资区域建议
- 二、重点投资产品建议

图表目录（部分）：

图表：2016-2017国内生产总值

图表：2016-2017居民消费价格涨跌幅度

图表：2017年居民消费价格比上年涨跌幅度（%）

图表：2016-2017年末国家外汇储备

图表：2016-2017财政收入

图表：2016-2017全社会固定资产投资

图表：2017年分行业城镇固定资产投资及其增长速度（亿元）

图表：2017年固定资产投资新增主要生产能力

图表：2017年房地产开发和销售主要指标完成情况

图表：半导体封装用键合丝行业产业链

图表：2016-2017半导体封装用键合丝行业市场供给

图表：2016-2017半导体封装用键合丝行业市场需求  
（GYWWPT）

图表详见正文

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/312117312117.html>